



Crème à braser DP 5505 SnPb(Ag)

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique DP 5505 SnPb(Ag)

Ver: 3.II 30-09-15

Page 1

Crème à braser sans nettoyage, sans halogènes

Description

DP 5505 SnPb(Ag) est une crème à braser sans nettoyage et sans halogènes pour les alliages avec plomb SnPb(Ag).

Elle est très résistante à l'humidité et aux températures élevées.

La rhéologie de la crème à braser **DP5505 SnPb(Ag)** permet de sérigraphie à des vitesses très élevées, même avec des pas fins, et elle convient parfaitement pour les applications 'Pin in Paste'.

La crème à braser **DP 5505 SnPb (Ag)** a un excellent mouillage et une bonne diffusion sur beaucoup de finitions, cuivre passivé (OSP) compris

La crème à braser **DP 5505 SnPb (Ag)** est sans halogènes, elle garantit une très grande fiabilité après refusion.

Les résidus après refusion sont minimums et claires. Les résidus ne perturbent pas les tests par 'flying probe' et les tests 'in situ'.

La crème à braser **DP5505 SnPb(Ag)** est classée **RO LO** suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle

Plus d'informations :

Profil de refusion	P. 2
Recommandations sur le profil	P. 2
Manipulation	P. 3
Résultats des tests	P. 3
Recommandations pour les paramètres	P. 4

Avantages :

- Grande stabilité / Long temps d'abandon
- Large fenêtre de process
- Excellent mouillage sur HASL, Ni/Au, OSP Cu, I-Sn, I-Ag
- Peu de 'voids'
- Peu de résidus après refusion
- Absolument sans halogènes

Disponibilité

Alliages	Contenu métallique	Taille poudre	Conditionnement
Sn63Pb37	Sérigraphie : 89% - 90%	standard type 3 (25— 45µ)	Pot de 500g
Sn62Pb36Ag2			Cartouche de 1kg—1,2kg—1,3kg
ATK anti-effet « Manhattan »	dispensing: 85%	type 4 et type 5 disponible pour certains alliages	Seringue de 5cc— 10cc— 30cc
			Autres conditionnements sur demande



Profil de refusion pour les alliages SnPb et SnPbAg

Description Générale

En général un profil de refusion linéaire ou avec un palier est recommandé. Des profils avec un palier peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes possédant une grande

diversité de composants ou bien pour diminuer ou éliminer la présence de « voids ».

Quand vous brasez une carte avec un four à refusion, faites attention à ne pas surchauffer les composants, en particulier

quand vous utilisez de la convection ou de l'infrarouge. Il est important de connaître les limites de températures de vos composants. Pour avoir une bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, contrôlez votre profil de refusion

avec des thermocouples. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en températures situés sur les côtés, au milieu et à proximité des gros composants.

Recommandations pour le profil

Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à 120°C une pente de 1-3°C/secondes est conseillée.

Des montées en températures plus rapides peuvent détruire des composants en raison de l'humidité absorbée.

Palier

A partir de 120°C et jusqu'à 170°C le palier doit avoir une pente de 0°C/s - 1°C/s. Dans certain cas un palier avec une température stable est utilisée pour rendre homogènes les différences de températures sur la carte. C'est souvent utilisé sur des circuits à grandes dispersions thermiques ou afin

de réduire la présence de « voids ».

Profil linéaire

Maximum 4°C/s en raison de la dilatation thermique des matériaux qui composent une carte électronique.

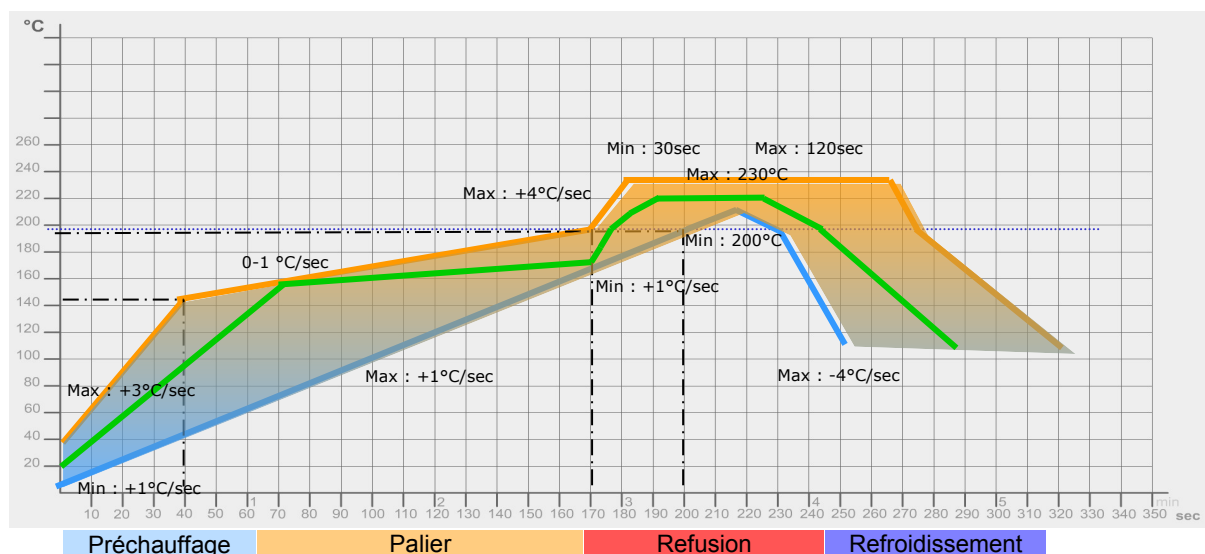
Refusion

Le pic de refusion dépend des spécifications des composants. En général entre 200°C et

230°C. Le temps de refusion (Au dessus du point de fusion de l'alliage utilisé) est en général entre 45 secondes et 90 secondes.

Refroidissement

Pas plus vite que -4°C/s en raison du coefficient de dilatation thermique des composants





Manipulation

Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 3° jusqu'à 7°C.

Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger avant toute utilisation.

Sérigraphie

Assurer un bonne étanchéité entre la carte et le pochoir. N'appliquer pas plus de pression sur les racles que nécessaire, le pochoir après la sérigraphie doit être propre. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la

crème à intervalle régulier.

Entretien

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie. Le produit de nettoyage **ISC 8020** est recommandé en lingettes ou en forme liquide.

Réutiliser la crème

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un test de sérigraphie et refusion avant toute utilisation en production.

Sécurité

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

Résultats des tests de fiabilité

conforme à la norme IPC J-STD-004A/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Quantité d'halogènes	0,0%	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.28.1
Argent chromate (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Classification du flux	RO LO	J-STD-004A
Environnement		
SIR test	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Propriétés	Résultats	Méthodes
Mécanique		
Test de microbilles	Après 15min passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
	Après 4h passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Test de mouillage	passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Test d'effondrement	Après 15min à 25°C passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	Après 10min à 150°C passé	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35



Recommandations et Paramètres d'utilisation

Sérigraphie

Vitesse : 20—150 mm/sec
Pression racles : 250g—350g/cm

Nettoyage : Toutes les 10 cartes
température d'utilisation : 15°C to 25°C

Pose des composants

« tack time »: > 8 heures

Refusion

Profil de refusion : Linéaire ou avec palier
Type de chauffe : Convection, ...

Tests

« flying probe »
« in situ »

Nom commercial du produit : Interflux® DP 5505 No-Clean, Halide Free Solder Paste

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com